

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 10 月 26 日(26.10.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/143994 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 85/86 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/059532
- (22) 国際出願日: 2011 年 4 月 18 日(18.04.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐々木 彰(SASAKI Akira) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 徳永 久次(TOKUNAGA Hisatsugu) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 藤村 徹夫(FUJIMURA Tetsuo) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP).
- (74) 代理人: 園田 吉隆, 外(SONODA Yoshitaka et al.); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 新宿三井ビル 3 4 階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

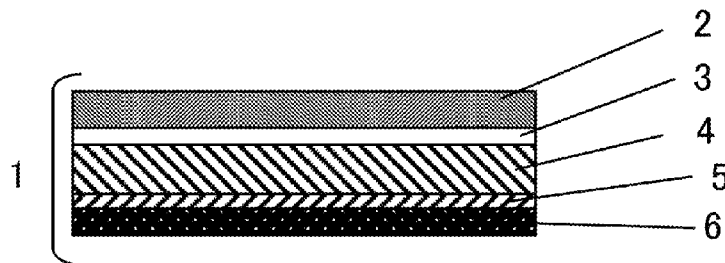
添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: COVER FILM

(54) 発明の名称: カバーフィルム

[図1]



(57) Abstract: Disclosed is a cover film, which comprises at least a base layer (A), an intermediate layer (B), a releasing layer (C) and a heat seal layer (D) that can be heat-sealed to a carrier tape, and wherein the heat seal layer (D) contains, as a main component, a styrene-acrylic copolymer that has a mass average molecular weight of 5,000-20,000. This cover film is suppressed in variation in release strength when separated from the carrier tape, and is capable of reducing problems in the mounting process of electronic components such as rupture of the cover film during the separation.

(57) 要約: 基材層(A)、中間層(B)、剥離層(C)、及びキャリアテープにヒートシール可能なヒートシール層(D)を少なくとも含んでなり、ヒートシール層(D)が、5000~20000の質量平均分子量を有するスチレン-アクリル系共重合体を主成分として含んでなる、カバーフィルムが開示される。このようなカバーフィルムは、キャリアテープから剥離される際の剥離強度のバラツキが小さく、カバーフィルムの破断等の、剥離の際の電子部品の実装工程でのトラブルが抑制できる。



WO 2012/143994 A1